

Mehr Power beim Lasern von Leiterplatten

Die LPKF Laser & Electronics AG ergänzt die Laserma- schinen-Reihe MicroLine durch noch leistungsstärkere Varianten

Ansprechpartner:

Cordula Krause-Widjaja
cordula.krause-
widjaja@lpkf.com
Tel. +49 (0)5131 7095-1327
Fax +49 (0)5131 7095-90

LPKF Laser & Electronics AG

Osteriede 7
D-30827 Garbsen
www.lpkf.de

Vorstand

Kai Bentz
(Vorstandssprecher, CFO)
Bernd Lange (CTO)
Dr. Christian Bieniek (COO)

Aktie:

Prime Standard
ISIN 0006450000

Abdruck frei, Beleg erbeten

» **Weitere Pressemeldungen**

80% mehr Laserleistung macht es möglich: Die effektive Schneidgeschwindigkeit der LPKF MicroLine Systeme lässt sich mit dem neuen UV-Laser deutlich steigern - je nach Layout und angewandtem Material sogar verdoppeln. Darüber hinaus steigt die Qualität des Ergebnisses. Die lasergestützte Bearbeitung von Substraten in der Leiterplattenfertigung sowie beim Vereinzeln bestückter Leiterplatten wird so noch effizienter. Besonders die Anwender von flexiblen und anspruchsvollen Leiterplattenmaterialien profitieren von den erweiterten Möglichkeiten, die die neue Laserquelle bietet.

UV-Laser sind ideale Werkzeuge, wenn Substrate unter minimaler thermischer oder mechanischer Beanspruchung im umgebenden Material bearbeitet werden sollen. Die LPKF UV-Laser-Systeme MicroLine 2000 und MicroLine 5000 sind hochspezialisierte Maschinen für das mikrogenaue Schneiden, Bohren, Vereinzeln oder Materialabtragen organischer und anorganischer Substrate.

Im Vergleich zu mechanischen Verfahren, bietet der UV-Lasereinsatz viele Vorteile: Den Geometrien sind keine Grenzen gesetzt. Der UV-Laser bearbeitet das Material berührungslos und kann ohne vorherige Maschinen-Umrüstzeiten eingesetzt werden. Die thermische Einflusszone im umgebenden Material ist praktisch vernachlässigbar, so dass eine hohe Packungsdichte erreicht werden kann. Darüber hinaus arbeiten die MicroLine Systeme grat- und nahezu staubfrei. So entstehen ideale Ergebnisse für die Mikroelektronik.

Mit der MicroLine 5000 lassen sich unterschiedlichste Leiterplattenvarianten bearbeiten – ob starr, starrflexibel oder flexibel. Als universell einsetzbares System ist die MicroLine 5000 geeignet für alle industriüblichen Materialmaße bis zu 21“ x 24“. Gerade bei besonders anspruchsvollen Geometrien erreicht das System präzise Schnitte bei hohen Geschwindigkeiten. Mit der Maschine sind Vias in Größen > 20 µm realisierbar.

Die MicroLine 2000 ist ein ideales System zum Trennen bestückter Leiterplatten sowie zum Schneiden und Vereinzeln von flexiblen Leiterplatten

und Coverlayern. Minimale Schutzzonen zu Leiterbahnen und Bauteilen ermöglichen eine optimale Ausnutzung der vorhandenen Leiterplattenfläche und unterstützen den Megatrend Miniaturisierung.

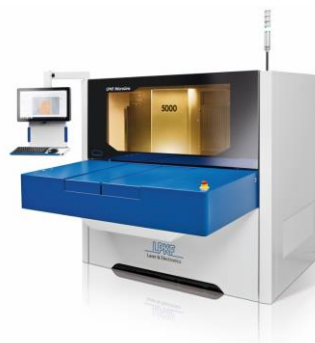
Mit den vorhandenen Schnittstellen integrieren sich die MicroLine Systeme nahtlos in vorhandene Manufacturing Execution Systeme (MES). Das Lasersystem übergibt operative Parameter, Maschinendaten, Tracking & Tracing-Werte und Informationen zu einzelnen Produktionsläufen. So sind die Produktionsdaten zuverlässig nachzuverfolgen – ein besonders wichtiger Punkt bei sicherheitsrelevanten Anwendungen.

Abb. 1: LPKF_MicroLine 2000_Ci



Die MicroLine 2000 mit neuer, leistungsstarker Laserquelle erhöht als Inline-Variante Taktzeiten von SMT-Linien.

Abb. 2: LPKF_1501_MicroLine_5000_TF_004



Die MicroLine 5000 erreicht mit der neuen Laserquelle eine Verdoppelung der Performance: Schnellere Schnitte und kürzere Bohrzeit bei sogar höherer Bearbeitungsqualität

Über LPKF

LPKF Laser & Electronics AG produziert Maschinen und Lasersysteme, die in der Elektronikfertigung, der Medizintechnik, der Automobilindustrie und bei der Herstellung von Solarzellen zum Einsatz kommen. Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt.